

## 高通骁龙400 MSM8926：四核A7、150Mbps LTE

高通的骁龙400 MSM8x26系列处理器面向主流和低端移动市场，之前有MSM8226、MSM8626两款型号，28nm LP工艺制造，整合四个ARM Cortex-A7 1.2GHz CPU核心、Adreno 305 GPU核心，网络制式方面MSM8226可以支持GSM/EDGE、TD-SCDMA、HSDPA+ 21.1Mbps、双卡双待，MSM8626则增加了1x/EVDO。

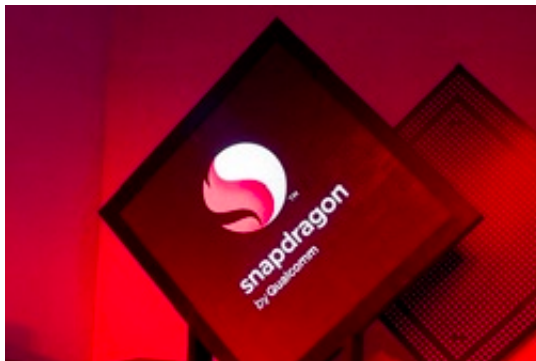
今天，高通又为骁龙400家族增加了一款新型号“MSM8926”。如果你熟悉高通的产品型号命名规则，就可以看出来它支持LTE。

事实上，MSM8926的硬件规格和MSM8226、MSM8626没什么不同，CPU、GPU架构和频率都是老样子，内存也是继续支持LPDDR2、LPDDR3，只是在网络制式上增加了来自MSM8974、MDM9x25的基带模块，也就是说它可以支持LTE Cat.4(FDD/TDD)，传输速率最高150Mbps，并支持载波聚合、DC-HSPA+ 42Mbps。

MSM8926还支持Miracast无线输出、VIVE 802.11ac Wi-Fi、蓝牙、FM、NFC等功能，系统支持Android 4.x、Windows Phone 8，还有QuickCharge 1.0快速充电技术(加快40%)。

高通称，MSM8926处理器主要面向中国和其它发展中国家(国内4G还没搭起来呢)，该处理器及其配套的参考设计平台将在今年晚些时候出货。

高通还宣称，骁龙400系列处理器已经累计有200多个基于参考平台的产品问世，来自40多家OEM厂商，而且还有100多套设计正在研发之中。



## TI推出最高电流密度的10A SWIFT DC/DC转换器

日前，德州仪器 (TI) 宣布推出一款采用极小型 3.5 毫米 × 3.5 毫米 HotRod QFN 封装并集成 MOSFET 的最新同步降压 DC/DC 转换器。该 SWIFT 10A TPS54020 不但支持最高电源密度，而且还包含频率同步、180 度异相位开关以及可选电流限制等功能，可在空间有限的高电压通信、游戏及工业计算应用中为 FPGA、片上系统 (SoC)、DSP 以及处理器供电。该转换器与 TI WEBENCH? 在线设计工具 配合使用，不仅可简化高电压 DC/DC 转换，同时还可加速设计进程。

最新 HotRod 集成电路封装不仅可保护集成 MOSFET 免受寄生电感干扰，而且还可实现低电阻，从而支持大电流、高效率以及小尺寸。散热增强型 15 引线封装比类似产品小 50%。

归属 TI 负载点 DC/DC 转换器系列，该系列包括采用 3 毫米 × 3 毫米 QFN 封装的 6A TPS54623 以及采用散热增强型 eTSSOP-20 裸焊盘封装的 12A LM21212-1 及 15A LM21215 转换器。

转换器的主要特性与优势集成型 8 毫欧姆高侧及 6 毫欧姆低侧 MOSFET 可在 12V 至 1V 电压下提供高达 96% 的效率；可选 6A、8A 及 10A 电流限制阈值不但可在低输出电流下实现效率优化，同时还可缩小外部组件尺寸；度异相位开关可将输入电流波纹锐减达 50%；至 1.2MHz 可调开关频率支持小型输出电感器及电容器，可进一步节省空间。

供货情况与封装采用 15 引线 HotRod QFN 封装的 TPS54020 DC/DC 转换器现已开始批量供货，可通过 TI 及其授权分销商进行订购。

